

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Bernd Jähne
Heidelberg Collaboratory for Image Processing (HCI)
am Interdisziplinären Zentrum für
Wissenschaftliches Rechnen (IWR),
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Berliner Straße 43 – Mathematikon (Bauteil B)
69120 Heidelberg
Tel.: (0 62 21) 54 14 860
E-Mail: Bernd.Jaehne@iwr.uni-heidelberg.de

Organisatorisches

Veranstaltungsort
Sony Europe B.V., Zweigniederlassung Deutschland
Stuttgart Technology Center
Hedelfinger Str. 61
70327 Stuttgart

Anmeldung
Vorzugsweise per Internet unter www.bv-forum.de

Teilnahmegebühren (alle Preise inkl. 19 % MwSt.)

Industrie	236,81 EUR
Forschungsinstitute (außeruniversitär)	116,62 EUR
Hochschule / Forschung	93,00 EUR
Studierende	46,00 EUR

EMVA-Mitglieder erhalten 10 % Rabatt.

Für die Gewährung reduzierter Teilnahmegebühren für Studierende ist vor Beginn des Bildverarbeitungsforums eine gültige Immatrikulationsbescheinigung vorzulegen.

Hotels

Bei Anreise am Vorabend: Hotelempfehlungen finden Sie online unter www.bv-forum.de. Teilnehmer buchen selbst.

Stornierung

Bei Stornierung Ihrer Tagungsteilnahme – ausschließlich schriftlich – bis zum 23. September 2019 werden pro Person 10,00 EUR Stornierungs- bzw. Bearbeitungsgebühren einbehalten. Bei späterer Stornierung ist eine Rückzahlung der Teilnahmegebühren ausgeschlossen. Das Benennen eines Ersatzteilnehmers ist möglich.

Programmänderungen vorbehalten. Stand 08/2019

Termine

74. Bildverarbeitungsforum – 3. März 2020
Thema: Maschinelles Lernen für die 3D-Bildgebung und -modellierung
Ort: Dentsply Sirona, Bensheim

75. Bildverarbeitungsforum – 7. Juli 2020
Thema: offen
Ort: offen

76. Bildverarbeitungsforum – 6. Oktober 2020
Thema: Sehende Maschinen
Ort: VDMA, Frankfurt

Das 73. Heidelberger Bildverarbeitungsforum findet statt mit freundlicher Unterstützung von

SONY

Organisation

AEON Verlag & Studio
GmbH & Co. KG
Alter Rückinger Weg 31
63452 Hanau

AEON | Verlag & Studio

Tel.: (0 61 81) 520 51-0
Fax: (0 61 81) 520 51-90
E-Mail: info@bv-forum.de
Internet: www.bv-forum.de

73. Heidelberger
Bildverarbeitungsforum

Moderne
Bildsensorik

Stuttgart
1. Oktober 2019



Das Heidelberger Bildverarbeitungsforum

Eine Initiative

- zur Vermittlung aktueller Forschungsergebnisse für die Anwendung in der industriellen Praxis und auf wissenschaftlich-technischem Gebiet
- zur Förderung fächerübergreifender Kontakte zwischen Industrie, Hochschulen und Forschungsinstituten
- zum Anstoßen von Kooperationen zwischen Industrie und Forschungsinstitutionen

Das Motto: Neue Konzepte für die Praxis

Mit drei Veranstaltungen pro Jahr sollen aktuelle Fortschritte im Bereich der Digitalen Bildverarbeitung aufbereitet werden. Damit soll aufgezeigt werden, wie sich neu entwickelte Bildverarbeitungsmethoden in der Praxis anwenden lassen. Das Heidelberger Bildverarbeitungsforum greift jeweils ein aktuelles Thema heraus, das von namhaften Fachwissenschaftlern verständlich vorgetragen wird.

Beirat

Dipl.-Ing. R. Godding

AICON 3D Systems GmbH, Braunschweig

Dr. S. Hader

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern

Prof. Dr. C. Heckenkamp

Hochschule Darmstadt

Prof. Dr. D. Merhof

RWTH Aachen

Dr.-Ing. K. Raguse

Volkswagen AG, Wolfsburg

Dr. R. Rösch

Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern

Dr. D. Schmundt

VITRONIC Dr.-Ing. Stein BV Systeme GmbH, Wiesbaden

Dr. D. Willersinn

Fraunhofer IOSB, Karlsruhe

Ziele und Inhalte des 73. Forums

In den letzten Jahren ist eine rasante Weiterentwicklung der Bildsensortechnologie zu beobachten.

Das 73. Heidelberger Bildverarbeitungsforum gibt einen fundierten Überblick über die vielfältigen Entwicklungen. Dies betrifft grundlegend neue Techniken für bessere Pixel, neuartige photonenzählende Bildsensoren und event-basierte Bildsensorik. Weiterhin geht es um neue bildgebende Modalitäten wie Polarisation und direkte Abstandsbestimmung und die Frage, inwiefern Kameras und Sensoren aus dem Konsumerbereich sich für optische Messtechnik eignen und wie man das Bildsignal weiter verbessern und modifizieren kann. Die Teilnehmer lernen damit, was ein Bildverarbeiter über heutige und zukünftige Bildsensoren wissen sollte.

Die Mittags- und Kaffeepause geben ausreichend Zeit für praktische Demonstrationen mit zum Inhalt des Forums passenden Exponaten in der Ausstellung, zur Diskussion der Posterbeiträge und für informative Gespräche unter den Teilnehmern und mit den Referenten.

Durch die Möglichkeit, die Exponate oder Poster mit einem Kurzvortrag („Teaser“ mit 2 Folien und 1 Minute Redezeit) vor der Mittagspause vorzustellen, und die ausgedehnte Mittags- und Kaffeepause erhält dieser Programmteil ein ihm gebührendes Gewicht. Die Teilnahme an der Industrieausstellung ist für registrierte Teilnehmer kostenfrei (max. ein Tisch mit Stromanschluss).



Programm

- 11:00 Vorstellung Sony Stuttgart Technology Center
M. Zumkeller
Sony Europe B.V., ZN Deutschland, Stuttgart
- 11:15 Deep Trench Isolation (DTI) is here to stay in the CIS World
Prof. Dr. A. Theuwissen
Harvest Imaging, Belgien
- 11:50 Polarisation Image Sensor and its Application
Yasutuka Hirasawa
Sony Corporation, Japan
- 12:25 Kurzpräsentationen („Teaser“) der Exponate und Poster (eine Minute, zwei Folien)
- 12:35 Mittagspause / Ausstellung / Poster
- 13:25 Laufzeitbildsensoren
Prof. Dr. B. Jähne
HCI, Universität Heidelberg
- 14:00 Photonenzählende Bildsensoren: eine Vielfalt neuer Möglichkeiten
Dr. J. Ruskowski
Fraunhofer IMS, Duisburg
- 14:35 Event-based image sensors
Dr. C. Matolin
Prophesee, Paris
- 15:10 Kaffeepause / Ausstellung / Poster
- 16:00 Geometrische Qualität handelsüblicher Kameras für die optische Messtechnik
H. Hastedt
Hochschule Oldenburg
- 16:25 Gebrochenzahliges Binning
Dr. J. Kunze
Basler AG
- 17:00 Ende der Veranstaltung